特 許 協 力 条 約

PCT

国際予備審查報告

REC'D	22	APR 2004
WIPO		PCT

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 X03013P	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP03/04489	国際出願日 (日.月.年) 09.04.03 優先日 (日.月.年) 09.04.02
	C1' H05K 1/14, 3/46, G01C 21/00, H01R 11/01
出願人(氏名又は名称) 株式会社 ザナ	-ヴィ・インフォマティクス
	国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。
× この国際予備審査報告には、附	
3. この国際予備審査報告は、次の内容	を含む。
I × 国際予備審査報告の基礎	
Ⅱ 【】 優先権	
	上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
IV 発明の単一性の欠如	
V X PCT35条(2)に規定す の文献及び説明 VI ある種の引用文献	る新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるため
WI × 国際出願の不備	
Ⅷ ■ 国際出願に対する意見	
国際予備審査の請求魯を受理した日 06.10.2003	国際予備審査報告を作成した日 07.04.2004
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区段が関三丁目4番:	特許庁審査官(権限のある職員) 3S 2921 落合 弘之

電話番号 03-3581-1101 内線 6222

I.	. 国際予備審査	報告の基礎				
1.	この国際予備: 応答するため PCT規則70.	に従口されび	下記の出願書類に と差し替え用紙は	基づいて作成さ 、この報告書に	れた。(法第6条(F おいて「出願時」とし	PCT14条)の規定に基づく命令に 、本報告書には添付しない。
] 出願時の国際	祭出願書類				
Σ	到 明細書 明細書 明細書	第 第	1-9	_ ページ、 _ ページ、 _ ページ、	出願時に提出された 国際予備審査の請求	さもの は書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
	請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第 第	1-10	項、 項、 	国際予備審査の請求	もの に基づき補正されたもの ・書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
×	図面図面図面	第 第 第	1-11	ページ/ 図、 ページ/図、 ページ/図、		もの 書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
2.	明細書の配列 明細書の配列 明細書の配列 明細書の配列	『表の部分 st 『表の部分 st	第	ページ、 ページ、 ページ、		書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
	上記の書類は、			を除くはか、この 語である	の国際出願の言語であ	ర .
	■ 国際調査(■ PCT規則■ 国際予備報	のために提b 則48.3(b)に 審査のために	出されたPCT規 いう国際公開の に提出されたPC	則23.1(b)にい 言語 T規則55.2また	う翻訳文の言語 は55.3にいう翻訳文の)言語 づき国際予備審査報告を行った。
	□ この国際は □ この国際は □ 出願後に、 □ 出願後に、 □ 出願後にも 書の提出が	出願に含まれ 出願と共に扱 この国際子 この国際子 是出した はあった	いる書面による配 計出された磁気デ が備審査(または が備審査(または 「による配列表が	列表 ィスクによる配 調査)機関に提 調査)機関に提 出願時における	列表 出された書面による監 出された磁気ディスク 国際出願の開示の範囲	! 列表
	請求の範囲 図面	第 第 図面の第 _	11-13	_ページ _項 ページ		
5.	400000、て	ク佣止かさ は	補充欄に示した れなかったものと こ考慮しなければ	して作成した。	(PCT担則アイト ゥイル)	D範囲を越えてされたものと認めら この補正を含む差し替え用紙は上

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用す 文献及び説明	可能性についての法第12条(PCT3)	5条(2)) に定める見解、	それを裏付ける
1. 見解			
新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	1-10	· 有 無
進歩性(IS)	請求の範囲	7-10 1-6	
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 請求の範囲	1-10	有 無
2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)	•		
文献1: JP 62-946 1987. 06. 1	70 U(株式会社日立製作 7	所)	

文献2: JP 8-148878 A (日本電気株式会社) 1996.06.07 文献3: JP 9-83233 A (株式会社日立製作所) 1997.03.28

文献4: JP 9-281890 A (株式会社ザナヴィ・インフォマティクス) 1997.10.31

文献5: JP 9-46015 A (ヒューレット・パッカード・カンパニー) 1997.02.14

& DE 19627663 A1 & GB 2303971 A & US 5657208 A

文献 6: JP 6-244522 A (日立電線株式会社) 1994.09.02

VII. 国際出願の不備

この国際出願の形式又は内容について、次の不備を発見した。

(1)

請求の範囲の記載に関して、一般に請求の範囲の記載は、保護が求められている事項(対象物)を発明の技術的特徴により明確かつ簡潔に記載することが求められている。そして、請求の範囲は発明を特定するために、「請求項Xの $\bigcirc\bigcirc\bigcirc$ において、 \triangle \triangle してなる $\bigcirc\bigcirc\bigcirc$ 。」のように、発明を明確にした記載で表現されるのが一般的である。

ある。 ところが、請求の範囲2,4-8は、末尾が「…る。」となっていることから、各 請求の範囲で保護を求めている事項(対象物)が不明である。

(2)

請求の範囲4の記載に関して、請求の範囲4で保護を求めている事項(対象物)が 不明である。

・請求の範囲1を参酌すれば、多層モジュール基板をベース基板に実装したものは、 「情報機器用回路基板装置」であって、「回路基板」ではないと考えられる。

補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V.2 欄の続き

請求の範囲1:

請求の範囲1に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1と、国際調査 報告で引用された文献2及び国際調査報告で引用された文献3とから進歩性を有しな

、高周波部と低周波部とをそれぞれ別の基板とすることは、文献2及び文献3に記載されており、文献1に記載のものにおいて、文献2及び文献3に記載の事項を採用することは、当業者にとって容易である。 また、プリント配線板を多層のものとすることは、当業者が適宜なし得る設計変更にすぎない。

請求の範囲2-3:

請求の範囲2-3に記載された発明は、文献1,文献2及び文献3と、国際調査報 告で引用された文献4とから進歩性を有しない。 文献4には、CPU、メモリ、グラフィック回路を有すること、電源回路、ジャイロ、GPS回路を有すること、ナビゲーション装置が記載されている。 各部品、各部品をどのように回路基板上に配置するかは、単なる設計的事項であ

請求の範囲4:

請求の範囲4に記載された発明は、文献1-4と、文献5とから進歩性を有しな 文献5には、マザーボードを共通化することが記載されている。

請求の範囲5:

請求の範囲5に記載された発明は、文献1-5から進歩性を有しない。 文献3には、高周波電子部品を実装した多層モジュール基板が記載されている。

請求の範囲6:

請求の範囲6に記載された発明は、文献1-5と、国際調査報告で引用された文献 6とから進歩性を有しない。 文献6には、矩形形状であり、4辺にコネクタ端子を有する基板が記載されてい る。

請求の範囲7-10:

請求の範囲7-10に記載された発明は、国際調査報告に引用されたいずれの文献 にも記載されておらず、当業者にとって自明なものでもない。 特に、4つのコネクタ端子を搬送アダプタに装着すること、位置規制用斜面を基部 に設けることは、何れの文献にも記載されていない。

請求の範囲

1. (補正後)

複数の低周波電子部品が実装されたベース基板と、

前記ペース基板の一方の面に実装され、少なくともCPUおよびメモリを含む 複数の高周波電子部品が実装された多層モジュール基板とを備え、

前記多層モジュール基板は前記ペース基板よりも小さい多層基板であり、内部層の配線パターンにより前記複数の高周波電子部品が配線されている情報機器用回路基板装置。

2. (補正後)

請求項1の情報機器用回路基板装置において、

前記多層モジュール基板は、少なくとも前記CPUおよびメモリに加えてさら にグラフィック回路を含み、

前記ペース基板は、少なくとも電源回路、ジャイロ、GPS回路を含む。

3. (補正後)

請求項1または2の情報機器用回路基板装置を備えるナビゲーション装置。

4. (補正後)

請求項2の多層モジュール基板を請求項2のベース基板に実装してなる回路基板において、

前記多層モジュール基板は、低価格モジュール用基板、前記低価格用モジュール基板に対してより高速に動作する高速モジュール用基板、または前記低価格用モジュール基板に対してより多くの機能を有する高機能モジュール用基板のいずれかであり、

前記ベース基板は、前記低価格モジュール用基板、高速モジュール用基板、および高機能モジュール用基板に共通である。

5. (補正後)

請求項4の回路基板に用いる多層モジュール基板において、

少なくとも一方の面に CP Uおよびメモリを含む複数の高周波電子部品が実装され、

内部層に形成された配線パターンにより前記複数の高周波電子部品がそれぞれ接続されている。

6. (補正後)

請求項5の多層モジュール基板において、

全体が矩形形状の基板であり、4辺の周縁にはそれぞれ別体のコネクタ端子が 半田接合されている。

7. (補正後)

請求項6に記載の多層モジュール基板において、

前記4つのコネクタ端子のそれぞれは、樹脂製の細長い基部と前記基部に固着 された複数本のピンとを備え、

前記4つのコネクタ端子のそれぞれは、搬送アダプタに前記基部が装着されて 搬送され、前記4つのコネクタ端子は前記搬送アダプタに装着された状態で基板 裏面に半田接合される。

8. (補正後)

請求項6に記載の多層モジュール基板において、

前記4つのコネクタ端子のそれぞれは、

樹脂製の細長い基部と、

前記基部に固着された複数本のピンと、

前記基部の両端にそれぞれ突設された、基板裏面に半田接合する際の位置合わせ用ピンと、

前記基部の両端にそれぞれ形成された半田接合時の位置規制用斜面とを備え、

基板の4隅のそれぞれには、前記位置合わせ用ピンが緩く嵌合される位置決め 用孔が一対づつ形成され、

前記位置合わせ用ピンを前記位置決め用孔に緩く嵌合した状態で、互いに隣接するコネクタ端子の前記位置規制用斜面が互いに当接することで、半田接合時の前記コネクタ端子の位置が規制される。

9. (補正後)

少なくとも一方の面に CPUおよびメモリを含む複数の高周波電子部品が実装され、

内部層に形成された配線パターンにより前記複数の高周波電子部品がそれぞれ 接続され、

全体が矩形形状の基板であり、4辺の周縁にはそれぞれ別体のコネクタ端子が 半田接合されており、

前記4つのコネクタ端子のそれぞれは、樹脂製の細長い基部と前記基部に固着された複数本のピンとを備え、

前記4つのコネクタ端子のそれぞれは、搬送アダプタに前記基部が装着されて 搬送され、前記4つのコネクタ端子は前記搬送アダプタに装着された状態で基板 裏面に半田接合されていることを特徴とする多層モジュール基板。

10. (補正後)

少なくとも一方の面にCPUおよびメモリを含む複数の高周波電子部品が実装され、

内部層に形成された配線パターンにより前記複数の高周波電子部品がそれぞれ接続され、

全体が矩形形状の基板であり、4辺の周縁にはそれぞれ別体のコネクタ端子が 半田接合されており、

前記4つのコネクタ端子のそれぞれは、

樹脂製の細長い基部と、

前記基部に固着された複数本のピンと、

前記基部の両端にそれぞれ突設された、基板裏面に半田接合する際の位置合わせ用ピンと、

前記基部の両端にそれぞれ形成された半田接合時の位置規制用斜面とを備え、 基板の4隅のそれぞれには、前記位置合わせ用ピンが緩く嵌合される位置決め 用孔が一対づつ形成され、

前記位置合わせ用ピンを前記位置決め用孔に緩く嵌合した状態で、互いに隣接するコネクタ端子の前記位置規制用斜面が互いに当接することで、半田接合時の前記コネクタ端子の位置が規制されることを特徴とする多層モジュール基板。

11. (削除)

12. (削除)

日本国特許庁 09. 2. 2004

13. (削除)

Rec'd PCT/PTO 08 60 72604



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

Anslation internat	PATENT COOPERAT	ION TREATY	PCT/JP2003/0044
slatic	PCT	1	
INTERNAT	TIONAL PRELIMINARY	EXAMINATION REPO	ORT
,	. (PCT Article 36 and	i Rule 70)	
Applicant's or agent's file reference X03013P	FOR FURTHER ACTION	See Notification of Trar Preliminary Examination Rep	
International application No. PCT/JP2003/004489	International filing date (day/r 09 April 2003 (09.04		lay/month/year) 2002 (09.04.2002)
international Patent Classification (IPC) or H05K 1/14, 3/46, G01C 21/00,			
Applicant XA	ANAVI INFORMATICS C	ORPORATION	
This international preliminary examples and is transmitted to the applicant		l by this International Prelimina	ary Examining Authority
2. This REPORT consists of a total of	of6 sheets, includi	ng this cover sheet.	
amended and are the basis	anied by ANNEXES, i.e., sheets of for this report and/or sheets conta he Administrative Instructions und	ining rectifications made before	
These annexes consist of a	total of 4 sheets.		
3. This report contains indications re	lating to the following items:		
I Basis of the report	t		
П Priority			
III Non-establishmen	nt of opinion with regard to novelt	y, inventive step and industrial	applicability
IV Lack of unity of in	nvention		
V Reasoned statement citations and explain	ent under Article 35(2) with regard anations supporting such statemen	l to novelty, inventive step or in it	idustrial applicability;
VI Certain documents	s cited		
VII Certain defects in	the international application		
VIII Certain observation	ons on the international applicatio	n .	· .
Date of submission of the demand	Date o	of completion of this report	
06 October 2003 (06.1	10.2003)	07 April 2004 (0°	7.04.2004)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Autho	rized officer	
Facsimile No.	Telepi	none No.	

International application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP2003/004489

I.	Basis	of the re	report		
1.	With	regard to	to the elements of the international application:*		
		the inte	ternational application as originally filed		
		the des	escription:		
		pages	3 <u>1</u> -	.9	, as originally filed
		pages			, filed with the demand
		pages		, filed with the letter of	
	\boxtimes	the clai	aims:		
		pages			, as originally filed
		pages			r with any statement under Article 19
ĺ		pages	3		, filed with the demand
		pages	1-10	, filed with the letter of _	09 February 2004 (09.02.2004)
	\boxtimes	the dra	rawings:		
		pages	1-1		
		pages			, filed with the demand
!		pages			
		the seque	uence listing part of the description:		
	_	pages			, as originally filed
ĺ		pages			, filed with the demand
		pages		, filed with the letter of _	
	These	the language the language or 55.3	to the language, all the elements marked above we onal application was filed, unless otherwise indicate ents were available or furnished to this Authority in anguage of a translation furnished for the purposes of anguage of publication of the international application anguage of the translation furnished for the purposed. 3). d to any nucleotide and/or amino acid seque	ed under this item. the following language of international search (under Ru on (under Rule 48.3(b)). ses of international preliminary	which is: ule 23.1(b)). y examination (under Rule 55.2 and/
•	prelin	contain filed to furnish furnish The st	examination was carried out on the basis of the sequined in the international application in written form together with the international application in compushed subsequently to this Authority in written form, when subsequently to this Authority in computer react statement that the subsequently furnished written	uence listing: . uter readable form. dable form.	
		internat	national application as filed has been furnished. Statement that the information recorded in compution furnished.		
4.			mendments have resulted in the cancellation of: the description, pages the claims, Nos11-13 the drawings, sheets/fig		
5.		beyond t	eport has been established as if (some of) the amend the disclosure as filed, as indicated in the Supplem	nental Box (Rule 70.2(c)).**	
i	in this and 70	is report (0.17).	sheets which have been furnished to the receiving rt as "originally filed" and are not annexed to	this report since they do no	ot contain amendments (Rule 70.16
**,	4ny re	eplaceme	nent sheet containing such amendments must be refe	erred to under item 1 and annex	xed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/JP 03/04489

v.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability citations and explanations supporting such statement
	Citations and explanations supporting of the citations and explanations supporting the citations and citations and citations and citations and citations and citations and citations are citations and citations are citations and citations and citations are citations and citations are citations and citations and citations are citations and citations and citations are citations and citations are citations and citations and citations are citations are citations and citations are citations and citations are citations are citations and citations are

Statement			
Novelty (N)	Claims	1-10	YES
1,0,0,0,0	Claims		NO
Turnative when (TS)	Claims	7-10	YES
Inventive step (IS)	Claims	1-6	NO
~ 1 . 1: _1: L:1:L./TA	Claims	1-10	YES
Industrial applicability (IA)			NO

Citations and explanations

Document 1: JP 62-94670 U (Hitachi, Ltd.), 17 June 1987

Document 2: JP 8-148878 A (NEC Corp.), 7 June 1996

Document 3: JP 9-83233 A (Hitachi, Ltd.), 28 March 1997

Document 4: JP 9-281890 A (Xanavi Informatics Corp.), 31

October 1997

Document 5: JP 9-46015 A (Hewlett Packard Co.), 14

February 1997, & DE 19627663 A1,

& GB 2303971 A, & US 5657208 A

Document 6: JP 6-244522 A (Hitachi Cable, Ltd.), 2

September 1994

Claim 1

The invention described in claim 1 does not involve an inventive step in the light of document 1 cited in the international search report, and document 2 and document 3 cited in the international search report.

The providing of a high-frequency part and a low-frequency part on mutually independent substrates is disclosed in document 2 and document 3, and a person skilled in the art could easily conceive of applying this feature disclosed in document 2 and document 3 to the invention disclosed in document 1.

Further, making a printed wiring board multi-layered is merely a feature fittingly determined at the discretion of a person skilled in the art.

Claims 2 and 3

The invention described in claims 2 and 3 does not involve an inventive step in the light of document 1, document 2, and document 3, and document 4 cited in the international search report.

Document 4 discloses a navigation device having a CPU, memory, and a graphics circuit, and having a power source circuit, a gyro, and a GPS circuit.

The selection of each component and the determination of how to arrange each component on a circuit board are simple design features.

Claim 4

The invention described in claim 4 does not involve an inventive step in the light of documents 1 to 4 and document 5.

Document 5 discloses the sharing of a motherboard.

Claim 5

The invention described in claim 5 does not involve an inventive step in the light of documents 1 to 5.

Document 3 discloses a multi-layer module board on which are mounted high-frequency electronic components.

Claim 6

The invention described in claim 6 does not involve an inventive step in the light of documents 1 to 5 and document 6 cited in the international search report.

Document 6 discloses a substrate having a rectangular shape and having connector terminals on the four sides.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/JP 03/04489

Claims 7 to 10

The invention described in claims 7 to 10 is not disclosed in any of the documents cited in the international search report, nor would it be obvious to a person skilled in the art.

In particular, the mounting of four connector terminals on a conveyor adapter and the providing of a position-controlling inclined plane on a base part are not disclosed in any of the documents.

International application No. PCT/JP 03/04489

VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

(1) In general, claims should clearly and concisely describe the technical features of the invention in order to specify the features (subject matter) for which protection is sought. And, in order to specify the invention, claims commonly use wording such as "the YYY of claim X, wherein YYY incorporates ZZZ" to clearly describe the invention.

However, claims 2 and 4 to 8 end with a verb [in the Japanese, a verb in the present tense ending in "-ru"], resulting in ambiguity as to for what feature (subject matter) protection is sought in each claim.

(2) It is unclear as to for what feature (subject matter) set forth in claim 4 protection is being sought.

In the light of claim 1, the item wherein a multilayer module board is mounted on a base board can be understood to be "a circuit board device for an information apparatus," and not "a circuit board."